

実装業界の本流にアクセスする技術専門誌

エレクトロニクス

実装技術 2021/2022

Electronic Packaging Technology

Vol.37/38 年間特集予定表

月号	発行日	特集名	対象展示会	申込メド	原稿メド
----	-----	-----	-------	------	------

2021

6月号	5月20日	●プリント配線板製造 ●実装プロセステクノロジー	JPCA SHOW、JISSO PUROTEC(5/26~5/28) 画像センシング展(6/9~6/11)	4月20日	4月25日
7月号	6月19日	●設計・解析・シミュレーション		5月20日	5月25日
8月号	7月20日	●はんだ付け技術		6月20日	6月25日
9月号	8月20日	●部品搭載技術		7月20日	7月25日
10月号	9月20日	●電子部品	関西 設計・製造ソリューション展(10/6~10/8) CEATEC JAPAN(10/19~10/22) 名古屋 ネブコンジャパン(10/27~10/29)	8月20日	8月25日
11月号	10月20日	●実装工程の効率化		9月20日	9月25日
12月号	11月20日	●半導体実装(3次元実装、その他)	ファインテック ジャパン(12/8~12/10) SEMICON JAPAN(12/15~12/17)	10月20日	10月25日

2022

1月号	12月20日	●インターネブコン	インターネブコン・ジャパン(1/19~1/21) neno tech(1/26~1/28)	11月20日	11月25日
2月号	1月20日	●検査技術		12月20日	12月25日
3月号	2月20日	●プリント配線板/ フレキシブルプリント配線板	設計・製造ソリューション展2021 (2022年3/16~3/18)	1月20日	1月25日
4月号	3月20日	●製品製造現場	名古屋 設計・製造ソリューション展(未定)	2月20日	2月25日
5月号	4月20日	●環境関連技術		3月20日	3月25日
6月号	5月20日	●プリント配線板製造 ●実装プロセステクノロジー	JPCA SHOW、JISSO PUROTEC(未定) 画像センシング展(未定)	4月20日	4月25日
7月号	6月20日	●設計・解析・シミュレーション	設計・製造ソリューション展2022 (2022年6/22~6/24)	5月20日	5月25日
8月号	7月20日	●はんだ付け技術		6月20日	6月25日
9月号	8月20日	●部品搭載技術		7月20日	7月25日
10月号	9月20日	●電子部品	関西 設計・製造ソリューション展(未定) CEATEC JAPAN(未定) 名古屋 ネブコンジャパン(未定)	8月20日	8月25日
11月号	10月20日	●実装工程の効率化		9月20日	9月25日
12月号	11月20日	●半導体実装(3次元実装、その他)	ファインテック ジャパン(未定) SEMICON JAPAN(未定) neno tech(未定)	10月20日	10月25日